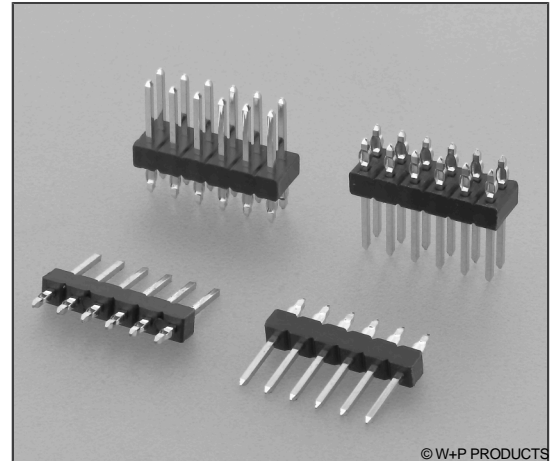


943PF / 944PF

Press-Fit Stiftheisen RM 2,54mm, gerade, 1-/2-reihig
Press-Fit Pin Header 2.54mm Pitch, Straight, Single / Double Row

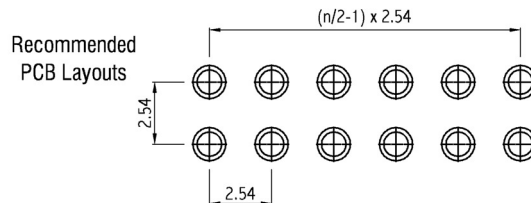
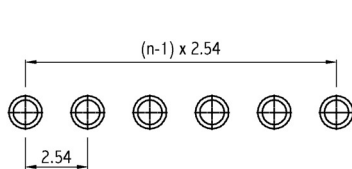
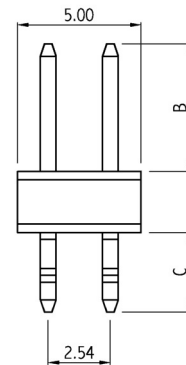
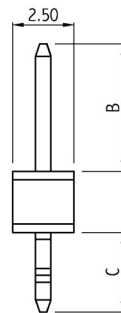
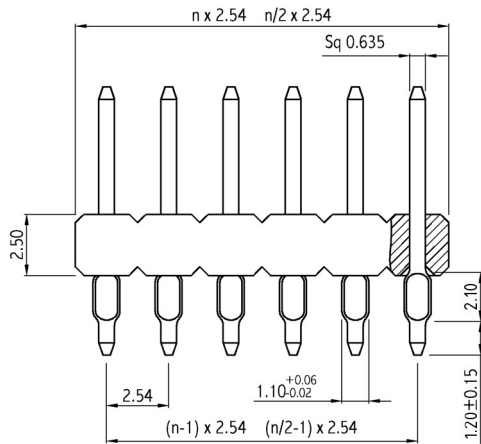
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
153PF 154 157 159 160/162 349 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



Einpressen über Stiftspitze.

Press-in over pin tip.

Einpresszone s. Tech. Informationen.

See technical information for PressFit zones.

Series*

944PF

943PF Einreihig
Single row
944PF Zweireihig
Double row

Dimensions*

10

10 B=5.20mm; C=3.30mm
13 B=6.80mm; C=3.30mm
14 B=8.10mm; C=3.30mm
15 B=10.20mm; C=3.30mm
16 B=13.00mm; C=3.30mm

Contacts*

06

01-40 Einreihig
Single row
02-80 Zweireihig
Double row

Plating*

00

00 Vergoldet
Gold plated
50 Verzinkt
Tin plated
110 Steckbereich 0,25µm Au, Einpresszone Au flash
Mating area 10µm Au, PressFit area Au flash

Weitere Stiftlängen auf Anfrage. B_{max}=20mm.

More pin length options on request. B_{max}=20mm.

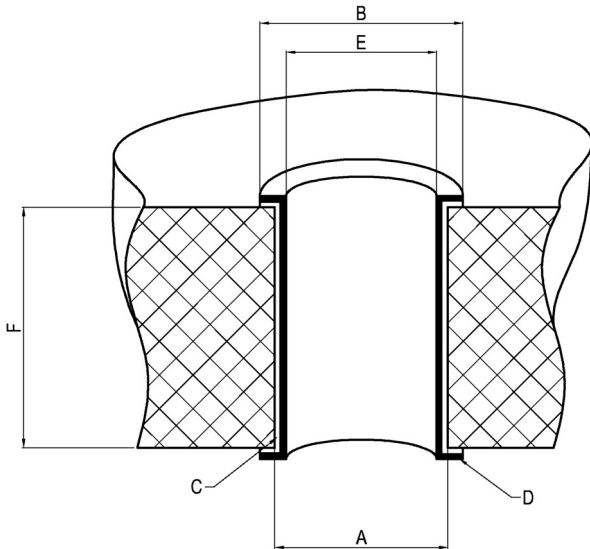
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

PressFit Lochdefinitionen

PressFit Hole Definitions

Empfohlene Maße der Einpresszonen unserer PressFit Stift- und Buchsenleisten

Recommended Dimensions of PressFit Through Holes



A	Bohrungs-Ø	Base Hole Ø
B	Ring-Ø	Ring Ø
C	Cu-Schicht	Cu Layer
D	Veredelung	Plating
E	Endloch-Ø	Final Hole Ø
F	Leiterplattendicke	PCB Thickness

Serie Series	RM / Pitch [mm]	A [mm]	B [mm]	C [µm]	D Option [µm]		E [mm]	F [mm]	Max. PCB-Kräfte Max. PCB Forces
					Sn	Au/Ni			
943PF, 944PF 943PFS, 944PFS	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 1,60	in: 150 N per pin
314PF	2,00	0,89±0,03	min. 1,30	min. 30	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	0,81±0,05	min. 1,60	in: 100 N per pin
153PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5~15 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 1,60	in: 89 N per pin
182PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 1,60	in: 89 N per pin
138PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00±0,05	min. 1,60	in: 150 N per pin